



Product End-of-Life Disassembly Instructions

Product Category: Notebooks

Marketing Name / Model

[List multiple models if applicable.]

Name / Model #1 HP ProBook Fortis 14 inch G9 Notebook PC

Name / Model #2 HP ProBook Fortis G9

Purpose: The document is intended for use by end-of-life recyclers or treatment facilities. It provides the basic instructions for the disassembly of HP Inc. products to remove components and materials requiring selective treatment, as defined by EU directive 2012/19/EC, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).

NOTE: Recyclers should sort plastic materials into resin streams for recycling based on the ISO 11469 plastic marking code on the plastic part. For any questions on plastic marking or identification of location of parts or components requiring selective treatment, please contact [HP's Sustainability Contact](#).

1.0 Items Requiring Selective Treatment

1.1 Items listed below are classified as requiring selective treatment. An "X" in the list of components and parts indicates the product contains the component or part requiring selective treatment

Item Description	Components and parts requiring selective treatments	Quantity of items included in product
Printed Circuit Boards (PCB) or Printed Circuit Assemblies (PCA) with a surface greater than 10 sq cm	☒ Main board (MB) PCB ☒ Solid state drive (SSD) PCB ☒ Wireless WAN module (WWAN) PCB ☐ Touch module PCB ☒ Power supply PCB ☐ External Keyboard (KB) ☐ External Mouse ☒ Others: I/O Board (1pcs)	5
Batteries, excluding Li-Ion batteries. This includes standard alkaline, coin or button style batteries	☒ RTC/CMOS battery ☐ Others: _____	1
Li-Ion batteries. Includes all Li-Ion batteries if more than one is provided with the product (such as a detachable notebook keyboard battery, etc.)	Li-ion battery(ies) are attached to the product by: ☒ screws ☐ snaps ☐ adhesive ☐ other. Explain _____	1
Mercury-containing components. For example, mercury in lamps, display backlights, scanner lamps, switches, batteries		0
Liquid Crystal Displays (LCD) with a surface greater than 100 sq cm. Includes background illuminated displays with gas discharge lamps	☒ Panel LCD	1
Cathode Ray Tubes (CRT)		0

EL-MF877-00

Template Revision D

Page 1

last updated May-2022

HP Inc. instructions for this template are available at [EL-MF877-01](#)

Item Description	Components and parts requiring selective treatments	Quantity of items included in product
Capacitors / condensers (Containing PCB/PCT)		0
Electrolytic Capacitors / Condensers measuring greater than 2.5 cm in diameter or height	☐ Power Supply capacitor(s) or condenser(s)	0
External electrical cables and cords	☒ AC power cord ☐ Audio, video or data cables ☐ Other: _____	1
Gas Discharge Lamps		0
Plastics containing Brominated Flame Retardants (not including external electrical cables and cords, PCBs or PCAs already listed as a separate item above)		0
Components and parts containing toner and ink, including liquids, semi-liquids (gel/paste) and toner. Include the cartridges, print heads, tubes, vent chambers, and service stations.		0
Components and waste containing asbestos		0
Components, parts and materials containing refractory ceramic fibers		0
Components, parts and materials containing radioactive substances		0
Components containing chlorofluorocarbons (CFC), hydrochlorofluorocarbons (HCFC) or hydrofluorocarbons (HFC), hydrocarbons (HC)		0

2.0 Tools Required

List the type and size of the tools that would typically be used to disassemble the product to a point where components and materials requiring selective treatment can be removed.

Tool Description	Tool Size (if applicable)
Screw driver	number#1

3.0 Product Disassembly Process

3.1 List the basic steps that should typically be followed to remove components and materials requiring selective treatment including the required steps to remove the external enclosure.

1. Follow steps described in each operation name of disassembly instruction in 3.2 section.
2. If parts can be removed without using a tool, remove it first
3. Use correct screwdriver and torque value before unlock the screw

3.2 Location of components requiring selective treatment. The photos and/or graphics below identify the location of the parts or components requiring selective treatment within the main unit. For End-of-Life product disassembly instructions of

external accessories including external power supply (EPS), external keyboard (KB) external mouse and external cables and cords, refer to the following URL: [End-of-Life Product Disassembly Instructions \(hp.com\)](#)

作业指导书

Sub-assembly name: HP ProBook Fortis G9 FA Disassembly SOP

1(1/1)站

别: Disassemble D cover screw

1.00

2021/10/9

作业名称:

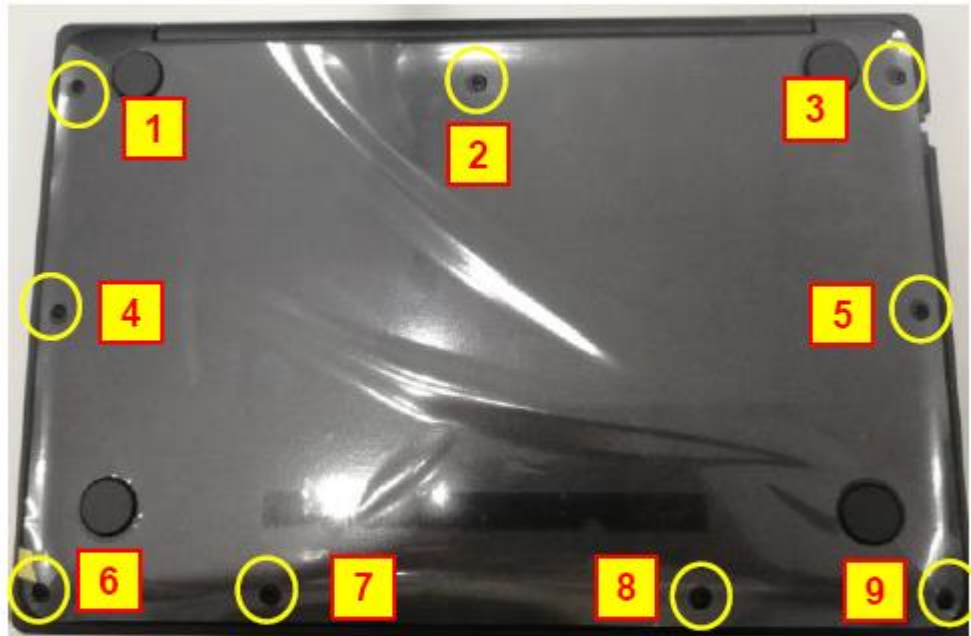
Ver.:

编辑日

期:

步骤:

1. Disassemble D cover screw
M2.5*6 (6052B0618202) *9颗
❖ Torque : 2.5±0.2 Kgf · cm



圖一

注意事项: PCB 板需轻拿轻放, 不得碰触板上之零件, 如有不良, 请立即通知领班或助理。

治具清单(治具规格)	数量	符号标识							
Electric screwdriver	1	+	◆	●	🔧	👂	👁	👋	⚡
		安全	质量	指令	工具	耳听	观察	手动	静电

编号: 3QBMDAP001-F003 版本: 4 机密等级: 一般 使用形式: 纸质档 保存期限: 最新版本 销毁方式: 撕毁

作业指导书

Sub-assembly name : HP ProBook Fortis G9 FA Disassembly SOP

2(1/1)站

别 : Disassemble D cover

1.00

2021/10/9

作业名称 :

Ver. :

编辑日

期 :

步骤 :

1. Disassemble D cover as photo show



圖一

注意事项：PCB 板需轻拿轻放，不得碰触板上之零件，如有不良，请立即通知领班或助理。

治具清单(治具规格)	数量	符号标识							
		安全	质量	指令	工具	耳听	观察	手动	静电

编号 : 3QBMDAP001-F003 版本 : 4 机密等级 : 一般 使用形式 : 纸质档 保存期限 : 最新版本 销毁方式 : 撕毁

作业指导书

Sub-assembly name : HP ProBook Fortis G9 FA Disassembly SOP

3(1/1)站

别 : Disassemble battery

1.00

2021/10/9

作业名称 :

Ver. :

编辑日

期 :

步骤 :

1. Disassemble Battery screw
M2.5*4(6052A0025801)*7
(图一)

❖ screwdriver number#1

❖ Torque : 2.0 ± 0.2 Kgf - cm

2. Disassemble Battery

Disassembly battery



图一

图二

注意事项：PCB 板需轻拿轻放，不得碰触板上之零件，如有不良，请立即通知领班或助理。

治具清单(治具规格)	数量	符号标识							
Electric screwdriver	1								
		安全	质量	指令	工具	耳听	观察	手动	静电

编号 : 3QBMDAP001-F003 版本 : 4 机密等级 : 一般 使用形式 : 纸质档 保存期限 : 最新版本 销毁方式 : 撕毁

作业指导书

Sub-assembly name : HP ProBook Fortis G9 FA Disassembly SOP

4(1/2)上

别 : Disassemble Audio/B FPC&FFC

1.00

2021/10/9

作业名称 :

Ver. :

编辑日

期 :

步骤 :

1. Open MB conn , Disassemble Audio/B FFC and FPC.
2. Take off Audio/B FFC and FPC adhesive.



圖一



圖二

注意事项：PCB 板需轻拿轻放，不得碰触板上之零件，如有不良，请立即通知领班或助理。

治具清单(治具规格)	数量	符号标识							
		安全	质量	指令	工具	耳听	观察	手动	静电

编号：3QBMDAP001-F003 版本：4 机密等级：一般 使用形式：纸质档 保存期限：最新版本 销毁方式：撕毁

作业指导书

Sub-assembly name : HP ProBook Fortis G9 FA Disassembly SOP

4(2/2)上

别 : Disassemble Audio/B

1.00

2021/10/9

作业名称 :

Ver. :

编辑日

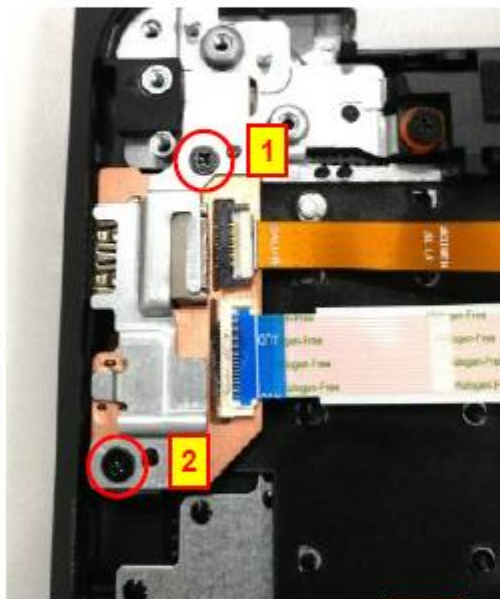
期 :

步骤 :

1. Disassemble Audio BRK screw
M2x4(6052B0081901)*2
2. Disassemble Audio/and BRK
(6053B1970001)

❖ screwdriver number#1

❖ Torque : 1.5 ± 0.2 Kg $\cdot$ cm



图一

注意事项：PCB 板需轻拿轻放，不得碰触板上之零件，如有不良，请立即通知领班或助理。

治具清单(治具规格)	数量	符号标识							
Electric screwdriver	1								
		安全	质量	指令	工具	耳听	观察	手动	静电

编号 : 3QBMDAP001-F003 版本 : 4 机密等级 : 一般 使用形式 : 纸质档 保存期限 : 最新版本 销毁方式 : 撕毁

作业指导书

Sub-assembly name : HP ProBook Fortis G9 FA Disassembly SOP

5(1/2)上

别 : Disassemble Webcam Cable

1.00

2021/10/9

作业名称 :

Ver. :

编辑日

期 :

步骤 :

- ☒ 1. Open MB conn , Disassemble Webcam Cable



圖一

注意事项：PCB 板需轻拿轻放，不得碰触板上之零件，如有不良，请立即通知领班或助理。

治具清单(治具规格)	数量	符号标识							
									
		安全	质量	指令	工具	耳听	观察	手动	静电

编号 : 3QBMDAP001-F003 版本 : 4 机密等级 : 一般 使用形式 : 纸质档 保存期限 : 最新版本 销毁方式 : 撕毁

作业指导书

Sub-assembly name : HP ProBook Fortis G9 FA Disassembly SOP

5(2/2)上

别 : Disassemble WWAN cable

1.00

2021/10/9

作业名称 :

Ver. :

编辑日

期 :

步骤 :

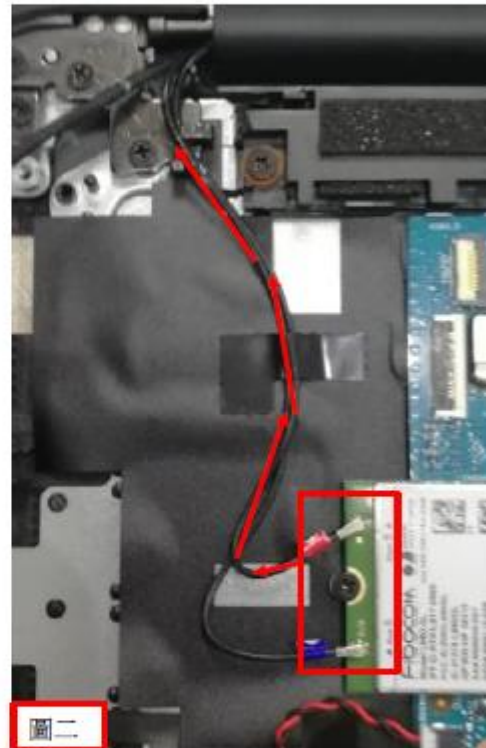
For WWAN SKU

- ✎ 1. Disassemble WWAN gasket (6054B2683901) .
- ✎ 2. Disassemble WWAN cable



圖一

WWAN gasket



圖二

注意事项：PCB 板需轻拿轻放，不得碰触板上之零件，如有不良，请立即通知领班或助理。

治具清单(治具规格)	数量	符号标识							
		+	◆	●	🧰	👂	👁	👋	⚡
		安全	质量	指令	工具	耳听	观察	手动	静电

编号 : 3QBMDAP001-F003 版本 : 4 机密等级 : 一般 使用形式 : 纸质档 保存期限 : 最新版本 销毁方式 : 撕毁

作业指导书

Sub-assembly name : HP ProBook Fortis G9 FA Disassembly SOP

别 : Disassemble WWAN

1.00

6(1/1)站

2020/10/30

作业名称 :

Ver. :

编辑日

期 :

步骤 :

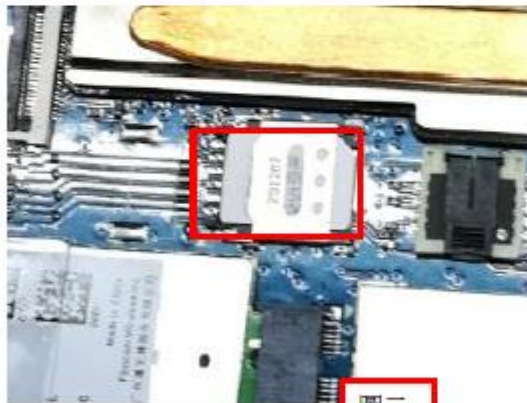
For WWAN SKU



圖一

1. Disassemble WWAN screw
M2*4(6052B0081901)*1, take off
WWAN (6042B0748101)
❖ screwdriver number#1
❖ Torque : $1.5 \pm 0.2\text{Kg} \cdot \text{cm}$
2. Disassemble SIM card (6042B0665201)

Disassembly WWAN



圖二

注意事项：PCB 板需轻拿轻放，不得碰触板上之零件，如有不良，请立即通知领班或助理。

治具清单(治具规格)	数量	符号标识							
Electric screwdriver	1								
		安全	质量	指令	工具	耳听	观察	手动	静电

编号 : 3QBMDAP001-F003 版本 : 4 机密等级 : 一般 使用形式 : 纸质档 保存期限 : 最新版本 销毁方式 : 撕毁

作业指导书

Sub-assembly name : HP ProBook Fortis G9 FA Disassembly SOP

7(1/2)版

别 : Disassemble EDP cable

1.00

2021/10/9

作业名称 :

Ver. :

编辑日

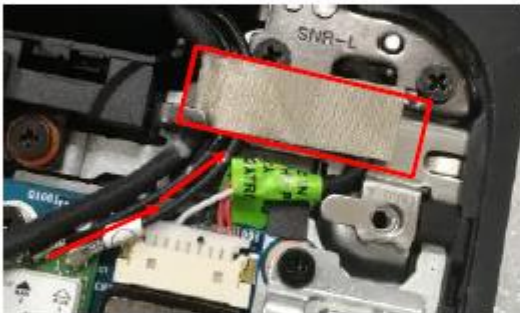
期 :

步骤 :

1. Open MB conn , Disassemble EDP cable
2. Take off the gasket , Disassemble EDP cable



圖一



圖二

注意事项：PCB 板需轻拿轻放，不得碰触板上之零件，如有不良，请立即通知领班或助理。

治具清单(治具规格)	数量	符号标识							
		安全	质量	指令	工具	耳听	观察	手动	静电

编号 : 3QBMDAP001-F003 版本 : 4 机密等级 : 一般 使用形式 : 纸质档 保存期限 : 最新版本 销毁方式 : 撕毁

作业指导书

Sub-assembly name : HP ProBook Fortis G9 FA Disassembly SOP

7(2/2)站

别 : Disassemble Antenna cable

1.00

2021/10/9

作业名称 :

Ver. :

编辑日

步骤 :

1. Tear off the mylar(6054B2605201)
2. Disassemble Antenna cable



圖一



圖二

注意事项：PCB 板需轻拿轻放，不得碰触板上之零件，如有不良，请立即通知领班或助理。

治具清单(治具规格)	数量	符号标识							
		安全	质量	指令	工具	耳听	观察	手动	静电

编号 : 3QBMDAP001-F003 版本 : 4 机密等级 : 一般 使用形式 : 纸质档 保存期限 : 最新版本 销毁方式 : 撕毁

作业指导书

Sub-assembly name : HP ProBook Fortis G9 FA Disassembly SOP

8(1/2)版

别 : Disassemble DC-IN cable

1.00

2021/10/9

作业名称 :

Ver. :

编辑日

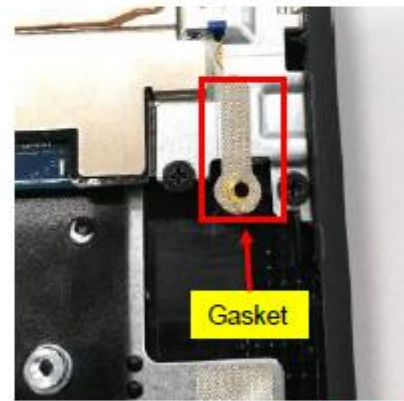
期 :

步骤 :

- ☒ 1. Disassemble DC-IN cable
- ☒ 2. Tear off the gasket (6054B0110801)



圖一



圖二

注意事项：PCB 板需轻拿轻放，不得碰触板上之零件，如有不良，请立即通知领班或助理。

治具清单(治具规格)	数量	符号标识							
		安全	质量	指令	工具	耳听	观察	手动	静电

编号 : 3QBMDAP001-F003 版本 : 4 机密等级 : 一般 使用形式 : 纸质档 保存期限 : 最新版本 销毁方式 : 撕毁

作业指导书

Sub-assembly name : HP ProBook Fortis G9 FA Disassembly SOP

8(2/2)上

别 : Disassemble SSD Shielding

1.00

2021/10/9

作业名称 :

Ver. :

编辑日

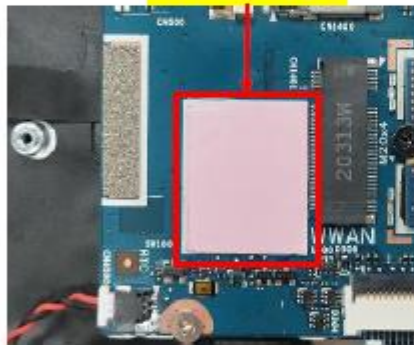
期 :

步骤 :

For WWAN SKU

1. Disassemble Thermal PAD(6054B2613601)
2. Disassemble SSD Shielding (6053B1973501)

Thermal PAD



图一



图二

注意事项：PCB 板需轻拿轻放，不得碰触板上之零件，如有不良，请立即通知领班或助理。

治具清单(治具规格)	数量	符号标识							
Ion FAN	1								
		安全	质量	指令	工具	耳听	观察	手动	静电

编号：3QBMDAP001-F003 版本：4 机密等级：一般 使用形式：纸质档 保存期限：最新版本 销毁方式：撕毁

作业指导书

Sub-assembly name : HP ProBook Fortis G9 FA Disassembly SOP

别 : Disassemble KB FPC&TP FFC

1.00

9(1/1)版

2021/10/9

作业名称 :

Ver. :

编辑日

期 :

步骤 :



图一



图二



图三

1. Open KB CONN , Disassemble K/B Membrane
2. Disassemble Speaker conn
3. Open TP CONN , Disassemble Click pad FFC.



图四

注意事项：PCB 板需轻拿轻放，不得碰触板上之零件，如有不良，请立即通知领班或助理。

治具清单(治具规格)	数量	符号标识							
		安全	质量	指令	工具	耳听	观察	手动	静电

编号 : 3QBMDAP001-F003 版本 : 4 机密等级 : 一般 使用形式 : 纸质档 保存期限 : 最新版本 销毁方式 : 撕毁

作业指导书

Sub-assembly name : HP ProBook Fortis G9 FA Disassembly SOP

10(1/1)

别 : Disassemble WLAN&SSD

1.00

2021/10/9

作业名称 :

Ver. :

编辑日

期

步骤 :



圖一

For HP ProBook Fortis G9

1. Disassemble WLAN&SSD&Thermal screw M2x4 (6052B0081901) *3
2. Disassemble WLAN and SSD

For HP ProBook Fortis G10

1. Disassemble WLAN&SSD&Thermal screw M2x4 (6052B0081901) *4
 2. Disassemble WLAN and SSD
- ❖ screwdriver number#1
❖ Torque : 1.5 ± 0.2Kgf · cm

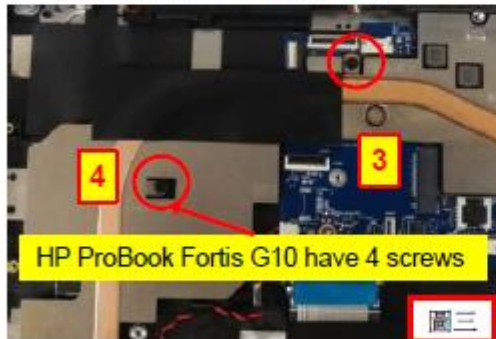


圖二

For WWAN SKU

2. Disassemble gasket (6054B1754901)
- ❖ WLAN SKU no gasket

Disassembly SSD



圖三



圖四

注意事项：PCB 板需轻拿轻放，不得碰触板上之零件，如有不良，请立即通知领班或助理。

治具清单(治具规格)	数量	符号标识							
Electric screwdriver	1								
		安全	质量	指令	工具	耳听	观察	手动	静电

编号 : 3QBMDAP001-F003 版本 : 4 机密等级 : 一般 使用形式 : 纸质档 保存期限 : 最新版本 销毁方式 : 撕毁

作业指导书

Sub-assembly name : HP ProBook Fortis G9 FA Disassembly SOP

别 : Disassemble IO BRK

1.00

11(1/1)

2021/10/9

作业名称 :

Ver. :

编辑日

期 :

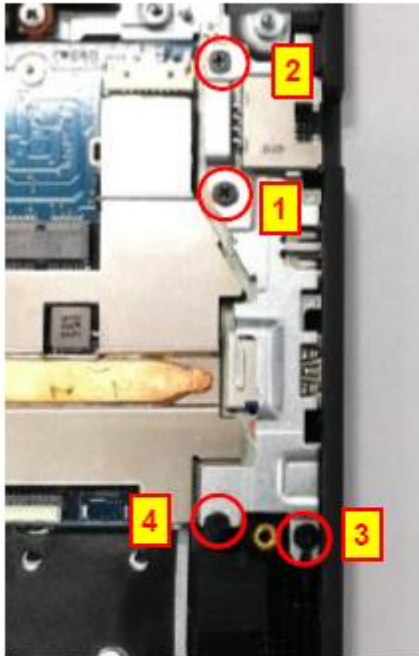
步骤 :

1. Disassemble IO BRK screw
M2x4(6052B0081901)*4.

❖ screwdriver number#1

❖ Torque : 1.5 ± 0.2 Kgf · cm

2. Take off IO BRK



Disassembly I/O board

图一

注意事项：PCB 板需轻拿轻放，不得碰触板上之零件，如有不良，请立即通知领班或助理。

治具清单(治具规格)	数量	符号标识							
Electric screwdriver	1								
		安全	质量	指令	工具	耳听	观察	手动	静电

编号：3QBMDAP001-F003 版本：4 机密等级：一般 使用形式：纸质档 保存期限：最新版本 销毁方式：撕毁

作业指导书

Sub-assembly name : HP ProBook Fortis G9 FA Disassembly SOP

12(1/1)

别 : Disassemble Thermal

1.00

2021/10/9

作业名称 :

Ver. :

编辑日

期 :

步骤 :

1. Disassemble Thermal Module screw
M2x2.5 (6052B0120001)*4 , take off thermal
- ❖ screwdriver number#1
- ❖ Torque : $1.5 \pm 0.2\text{Kgf} \cdot \text{cm}$



图一

注意事项：PCB 板需轻拿轻放，不得碰触板上之零件，如有不良，请立即通知领班或助理。

治具清单(治具规格)	数量	符号标识							
Electric screwdriver	1								
		安全	质量	指令	工具	耳听	观察	手动	静电

编号 : 3QBMDAP001-F003 版本 : 4 机密等级 : 一般 使用形式 : 纸质档 保存期限 : 最新版本 销毁方式 : 撕毁

作业指导书

Sub-assembly name : HP ProBook Fortis G9 FA Disassembly SOP

13(1/1)

别 : Disassemble RTC battery

1.00

2021/10/9

作业名称 :

Ver. :

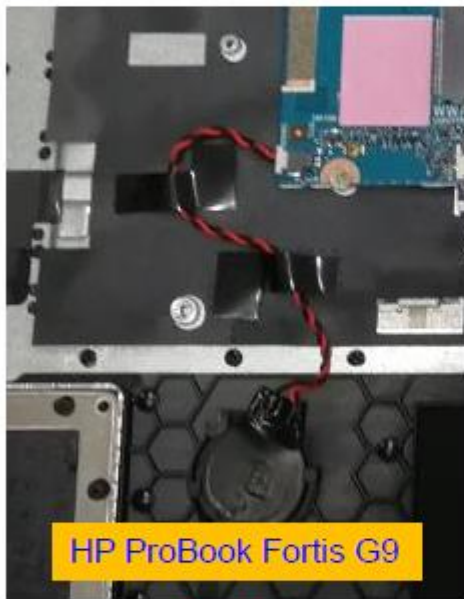
编辑日

期 :

步骤 :

1. Disassemble RTC battery.

Disassembly RTC battery



圖一



圖二

注意事项：PCB 板需轻拿轻放，不得碰触板上之零件，如有不良，请立即通知领班或助理。

治具清单(治具规格)	数量	符号标识							
									
		安全	质量	指令	工具	耳听	观察	手动	静电

编号：3QBMDAP001-F003 版本：4 机密等级：一般 使用形式：纸质档 保存期限：最新版本 销毁方式：撕毁

作业指导书

Sub-assembly name : HP ProBook Fortis G9 FA Disassembly SOP

14(1/2)

别 : Disassemble M/B

1.00

2021/10/9

作业名称 :

Ver. :

编辑日

期 :

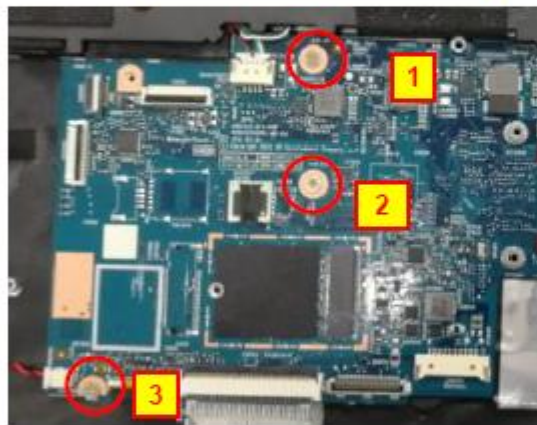
步骤 :

For HP ProBook Fortis G9

1. Disassemble MB screw M2.5x3
(6052B0154801)*6

❖ screwdriver number#1
❖ Torque : 2.0± 0.2Kgf · cm

Disassembly MB



图一

注意事项：PCB 板需轻拿轻放，不得碰触板上之零件，如有不良，请立即通知领班或助理。

治具清单(治具规格)	数量	符号标识							
Electric screwdriver	1	+	◆	●	🧰	💡	👁	👤	⚡
		安全	质量	指令	工具	耳听	观察	手动	静电

编号 : 3QBMDAP001-F003 版本 : 4 机密等级 : 一般 使用形式 : 纸质档 保存期限 : 最新版本 销毁方式 : 撕毁

作业指导书

Sub-assembly name : HP ProBook Fortis G9 FA Disassembly SOP

14(2/2)

别 : Disassemble M/B

1.00

2021/10/9

作业名称 :

Ver. :

编辑日

期 :

步骤 :

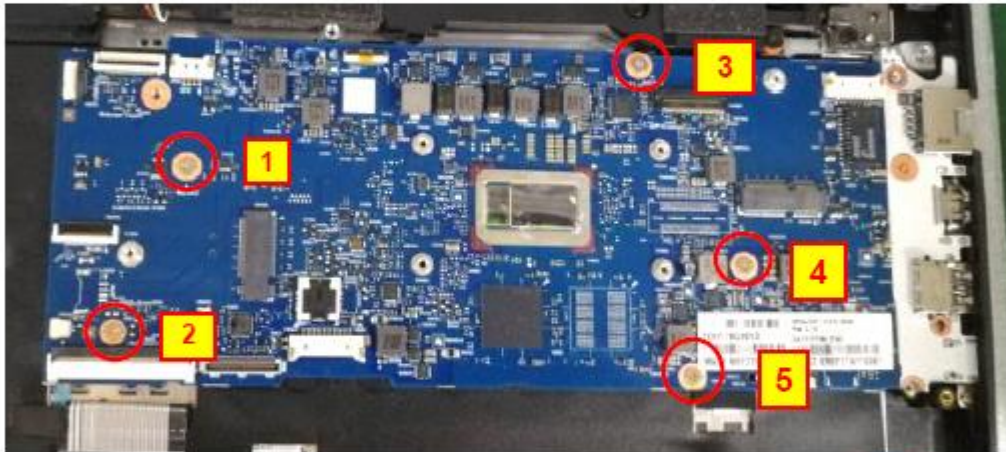
For HP ProBook Fortis G10

1. Disassemble MB screw M2.5x3 (6052B0154801)*5

❖ screwdriver number#1

❖ Torque : $2.0 \pm 0.2 \text{ Kg} \cdot \text{cm}$

Disassembly MB



图一

注意事项：PCB 板需轻拿轻放，不得碰触板上之零件，如有不良，请立即通知领班或助理。

治具清单(治具规格)	数量	符号标识							
Electric screwdriver	1								
		安全	质量	指令	工具	耳听	观察	手动	静电

编号 : 3QBMDAP001-F003 版本 : 4 机密等级 : 一般 使用形式 : 纸质档 保存期限 : 最新版本 销毁方式 : 撕毁

作业指导书

Sub-assembly name : HP ProBook Fortis G9 FA Disassembly SOP

15(1/3)

别 : Disassemble M/B

1.00

2021/10/9

作业名称 :

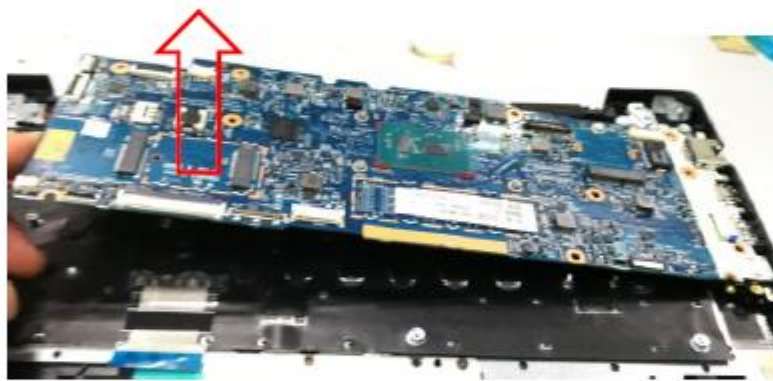
Ver. :

编辑日

期 :

步骤 :

1. Disassemble MB



图一

注意事项：PCB 板需轻拿轻放，不得碰触板上之零件，如有不良，请立即通知领班或助理。

治具清单(治具规格)	数量	符号标识							
Ion FAN	1								
		安全	质量	指令	工具	耳听	观察	手动	静电

编号：3QBMDAP001-F003 版本：4 机密等级：一般 使用形式：纸质档 保存期限：最新版本 销毁方式：撕毁

作业指导书

Sub-assembly name : HP ProBook Fortis G9 FA Disassembly SOP

15(2/3)

别 : Disassemble Mylar

1.00

2021/10/9

作业名称 :

Ver. :

编辑日

期 :

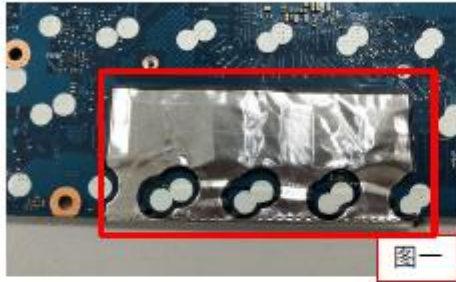
步骤 :



For Only WLAN SKU (No WWAN)

1. Tear off Mylar (6054B2611101)

❖HP ProBook Fortis G10 MB no Mylar



图一



图二

注意事项：PCB 板需轻拿轻放，不得碰触板上之零件，如有不良，请立即通知领班或助理。

治具清单(治具规格)	数量	符号标识							
		安全	质量	指令	工具	耳听	观察	手动	静电

编号：3QBMDAP001-F003 版本：4 机密等级：一般 使用形式：纸质档 保存期限：最新版本 销毁方式：撕毁

作业指导书

Sub-assembly name : HP ProBook Fortis G9 FA Disassembly SOP

别 : Disassemble Absorber

1.00

15(3/3)

2021/10/9

作业名称 :

Ver. :

编辑日

期 :

步骤 :

For WWAN SKU

1. Disassemble Absorber (6054B2610901)
2. Disassemble DDR Shielding (6053B1973701)



图一

注意事项：PCB 板需轻拿轻放，不得碰触板上之零件，如有不良，请立即通知领班或助理。

治具清单(治具规格)	数量	符号标识							
									
		安全	质量	指令	工具	耳听	观察	手动	静电

编号：3QBMDAP001-F003 版本：4 机密等级：一般 使用形式：纸质档 保存期限：最新版本 销毁方式：撕毁

作 业 指 导 书

Sub-assembly name : HP ProBook Fortis G9 FA Disassembly SOP

16(1/1)站

别 : Disassemble Hinge screw

1.00

2021/10/9

作 业 名 称 :

Ver. :

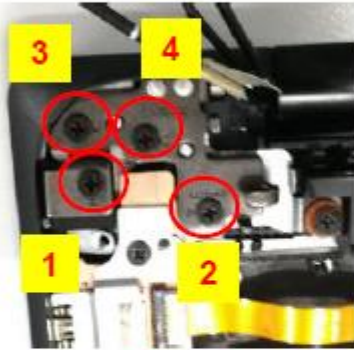
编辑日

期 :

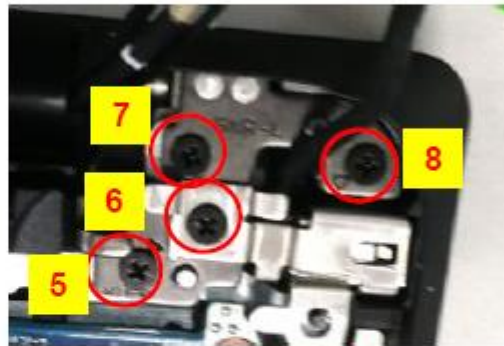
步骤 :

DC-IN cable	6017B1311801	信音
	6017B1311701	寶盈

1. Disassemble Hinge screw(6052B0094301)*8
❖ screwdriver number#1
❖ Torque : $3.0 \pm 0.2\text{Kgf} \cdot \text{cm}$
2. Take off DC-IN cable.



圖一



圖二



圖三

注意事项：PCB 板需轻拿轻放，不得碰触板上之零件，如有不良，请立即通知领班或助理。

治具清单(治具规格)	数量	符号标识							
Electric screwdriver	1								
		安全	质量	指令	工具	耳听	观察	手动	静电

编号 : 3QBMDAP001-F003 版本 : 4 机密等级 : 一般 使用形式 : 纸质档 保存期限 : 最新版本 销毁方式 : 撕毁

作业指导书

Sub-assembly name : HP ProBook Fortis G9 FA Disassembly SOP

17(1/1)

别 : Disassemble LCM & TOP

1.00

2021/10/9

作业名称 :

Ver. :

编辑日

期 :

步骤 :



圖一

1. Open the unit to more than 90 degree , take off LCM and TOP.
2. Disassemble speaker screw M2.0*2.0 (6052B0618101) *4.
3. Take off speaker

❖ screwdriver number#1
❖ Torque : 3.0± 0.2Kgf · cm



圖二

圖一

Disassembly panel(LCD)

注意事项：PCB 板需轻拿轻放，不得碰触板上之零件，如有不良，请立即通知领班或助理。

治具清单(治具规格)	数量	符号标识							
Electric screwdriver	1								
		安全	质量	指令	工具	耳听	观察	手动	静电

编号 : 3QBMDAP001-F003 版本 : 4 机密等级 : 一般 使用形式 : 纸质档 保存期限 : 最新版本 销毁方式 : 撕毁

